

证券代码：301297

证券简称：富乐德

安徽富乐德科技发展股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2026-003

投资者关系活动类别	☒ 特定对象调研 ☐ 分析师会议 ☐ 媒体采访 ☐ 业绩说明会 ☐ 新闻发布会 ☐ 路演活动 ☐ 现场参观 ☐ 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	中信证券 周光裕 华福证券 唐保威 泰康基金 俞朕飞 中银基金 时文博 申港证券 王婷、邵永礼、王啟伟 季胜投资 徐小喆
时间	2026年07月23日 10:00-11:30
地点	上海市宝山区山连路181号会议室
上市公司接待人员姓名	董事会秘书 颜华 富乐华投资部长 刘立波
投资者关系活动主要内容介绍	1、请简要介绍公司目前的主营业务布局。 答：公司围绕“泛半导体设备精密洗净+半导体核心零部件材料”双轮驱动战略进行布局，主要有三大业务板块：一是泛半导体设备精密洗净服务，包括半导体、TFT、OLED设备的精密洗净、检测及衍生增值服务；二是功率半导体覆铜陶瓷载板业务，包括DCB、AMB、DPC等产品；三是半导体核心零部件业务，包括ALN加热器、静电吸盘（ESC）。三大板块协同共振，共同构建公司“服务+材料+部件”的综合解决方案能力。 2、公司如何看待国内半导体设备国产化率提升这一趋势对公司

	洗净业务的影响？ 答：“十五五”规划将集成电路列为战略性新兴产业之首，政策持续扶持半导体装备国产化。在此背景下，晶圆厂扩产步伐加快，公司精密洗净服务作为晶圆制造过程中不可或缺的配套环节，为国产设备厂商和晶圆厂提供稳定、高效的洗净服务，有效保障了国产设备的稳定运行与良率提升。目前公司一方面将加强技术研发，布局先进制程洗净技术；另一方面将进一步布局新的洗净基地，完善全国产能布局与基地建设规划。随着国产化进程的深入推进，公司有望持续受益于晶圆产能扩张带来的洗净服务需求增长。 3、公司覆铜陶瓷载板业务主要有哪些产品线？各自的应用领域有何不同？ 答：公司全资子公司富乐华专注于覆铜陶瓷载板领域，拥有近三十年研发生产经验，是国内外少数实现全流程自制的覆铜陶瓷载板生产商。主要产品包括：DCB（直接覆铜陶瓷载板），将铜箔直接烧结在陶瓷表面，具有优秀的热循环性、高导热率和高绝缘性，主要应用于新能源汽车、工业控制、白色家电、轨道交通及新能源发电等领域；AMB（活性金属钎焊覆铜陶瓷载板），利用活性金属材料实现焊接，结合强度更高、可靠性更好，主要应用于新能源汽车800V高压平台、轨道交通、AI数据中心等碳化硅功率模块场景；DPC（直接镀铜陶瓷载板），通过磁控溅射、图形电镀实现陶瓷表面金属化，线路精度高，可垂直互连，主要应用于光模块TEC热电制冷器件、激光雷达、光通信等领域。 4、公司在自研材料方面有哪些突破？ 答：公司成功实现了自研SiN氮化硅陶瓷基板的技术突破，打通了从自研氮化硅瓷片到AMB活性金属焊接，再到高阶封装组件的全产业链闭环。这一“材料-基板-封装”的全产业链闭环模式，有助于降低AMB产品成本，形成底层技术壁垒和成本护城河。此外，公司还在DAB直接键合铝基板方向进行布局。 5、公司在技术研发层面的布局与未来方向是什么？ 答：公司目前已构建起涵盖精密清洗、表面处理及涂层、分析检测等多元技术领域的综合研发平台。在此基础上，我们充分发挥与富乐华研究院的技术协同优势，形成内外联动的创新合力。未来，公司将紧跟下游先进制程演进和产业升级趋势，持续加大研发资源投入，着力夯实自主专利体系，并通过前瞻性技术储备和新服务方案的落地，满足客户不断变化的需求，保持市场竞争优势。
--	--

	6、公司如何看待未来的发展前景？ 答：从外部环境看，半导体产业链自主可控进程持续深化，国产替代需求旺盛，为公司带来显著增量空间；从内部战略看，通过成功整合富乐华，公司已构建起“精密洗净服务+核心零部件制造”双主业并进的业务格局。公司将充分利用两个业务板块的协同效应，持续进行技术创新和市场拓展，致力于成为全球领先的泛半导体领域综合解决方案提供商，为投资者创造长期、稳定的回报。
关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明	本次活动不涉及未公开披露的重大信息。
附件清单（如有）	
日期	2026年07月23日